

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 16 日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/054373 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08L 101/00, C08K 3/00,
3/28, 3/32, 5/16, 5/49, C08L 101/16

区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo
(JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017728

(74) 代理人: 小池 晃, 外(KOIKE, Akira et al.); 〒1000011
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 7 号 大和生命ビ
ル 1 1 階 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 29 日 (29.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-403475 2003 年 12 月 2 日 (02.12.2003) JP
特願2003-403477 2003 年 12 月 2 日 (02.12.2003) JP
特願2003-403476 2003 年 12 月 2 日 (02.12.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー
株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1410001
東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀江 毅 (HORIE,
Takeshi) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北品川 6 丁
目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 山田 心
一郎 (YAMADA, Shinichiro) [JP/JP]; 〒1410001 東京
都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会
社内 Tokyo (JP). 藤平 裕子 (FUJIHIRA, Yuko) [JP/JP];
〒1410001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 森 浩之 (MORI, Hi-
royuki) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北品川 6 丁
目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 野口 勉
(NOGUCHI, Tsutomu) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: RESIN COMPOSITION, MOLDING THEREOF AND PROCESS FOR PRODUCING THE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 樹脂組成物及びこの樹脂組成物を用いた成形品並びに樹脂組成物の製造方法

(57) Abstract: A biodegradable resin composition comprising at least one biodegradable organic polymeric compound, a flame retardant additive containing a phosphorous compound, and a hydrolysis inhibitor capable of inhibiting the hydrolysis of at least one organic polymeric compound. As an aliphatic polyester resin, use is made of polylactic acid, polycaprolactone, polyhydroxybutyric acid, polyhydroxyvaleric acid, polyethylene succinate, polybutylene succinate, polybutylene adipate, polymalic acid, microbially synthesized polyester or a copolymer containing at least one of these. As a polysaccharide, use is made of cellulose, starch, chitin, chitosan, dextran, a derivative of any of these or a copolymer containing at least one of these.

(57) 要約: 本発明は、生分解性を示す樹脂組成物であり、少なくとも 1 種の生分解性を示す有機高分子化合物と、リン含有化合物を含有する難燃系添加剤と、少なくとも 1 種の有機高分子化合物の加水分解を抑制する加水分解抑制剤とを含有する。脂肪族ポリエステル樹脂は、ポリ乳酸、ポリカプロラクトン、ポリヒドロキシ酪酸、ポリヒドロキシ吉草酸、ポリエチレンサクシネート、ポリブチレンサクシネート、ポリブチレンアジペート、ポリリンゴ酸、微生物合成ポリエステル、又はこれらのうち少なくとも 1 種を含む共重合体であり、多糖類は、セルロース、澱粉、キチン、キトサン、デキストラン、これらのうちいずれかの誘導体、又はこれらのうち少なくとも 1 種を含む共重合体である。

WO 2005/054373 A1